



Chipsmall Limited consists of a professional team with an average of over 10 year of expertise in the distribution of electronic components. Based in Hongkong, we have already established firm and mutual-benefit business relationships with customers from,Europe,America and south Asia,supplying obsolete and hard-to-find components to meet their specific needs.

With the principle of “Quality Parts,Customers Priority,Honest Operation,and Considerate Service”,our business mainly focus on the distribution of electronic components. Line cards we deal with include Microchip,ALPS,ROHM,Xilinx,Pulse,ON,Everlight and Freescale. Main products comprise IC,Modules,Potentiometer,IC Socket,Relay,Connector.Our parts cover such applications as commercial,industrial, and automotives areas.

We are looking forward to setting up business relationship with you and hope to provide you with the best service and solution. Let us make a better world for our industry!



Contact us

Tel: +86-755-8981 8866 Fax: +86-755-8427 6832

Email & Skype: info@chipsmall.com Web: www.chipsmall.com

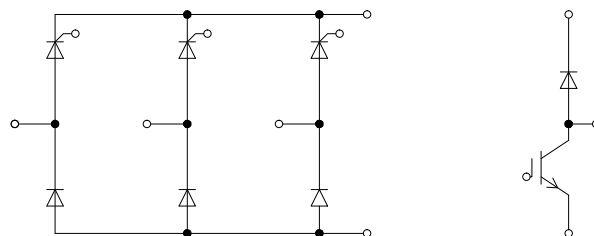
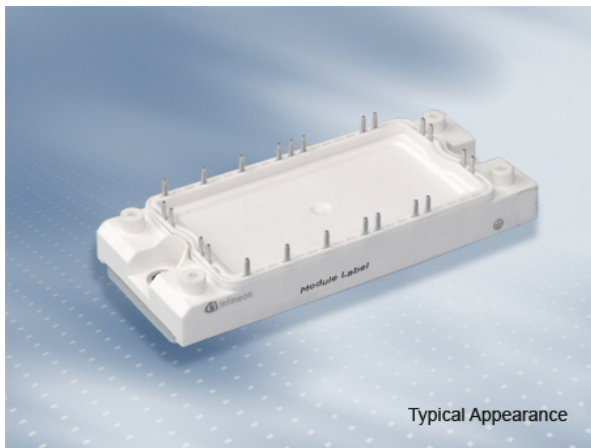
Address: A1208, Overseas Decoration Building, #122 Zhenhua RD., Futian, Shenzhen, China





EconoPACK™2 Modul
EconoPACK™2 module

Vorläufige Daten / Preliminary Data



$V_{CES} = 1200V$
 $I_{C\ nom} = 180A / I_{CRM} = 360A$

Typische Anwendungen

- Aktiver Gleichrichter
- Halbgesteuerte B6-Brücke

Typical Applications

- Active Rectifier
- Half Controlled B6-bridge

Mechanische Eigenschaften

- 2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
- Al₂O₃ Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Hohe Leistungsdichte
- Hohe mechanische Robustheit
- Isolierte Bodenplatte
- Kompaktes Design
- Kupferbodenplatte
- Lötverbindungstechnik
- RoHS konform
- Standardgehäuse

Mechanical Features

- 2.5 kV AC 1min Insulation
- Al₂O₃ Substrate with Low Thermal Resistance
- High Power Density
- High mechanical robustness
- Isolated Base Plate
- Compact design
- Copper Base Plate
- Solder Contact Technology
- RoHS compliant
- Standard Housing

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19	
approved by: RS	revision: 2.0	UL approved (E83335)



**Vorläufige Daten
Preliminary Data**

Diode, Gleichrichter / Diode, Rectifier

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip Maximum RMS forward current per chip	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	150	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom Maximum RMS current at rectifier output	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSM}	180	A
Stoßstrom Grenzwert Surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	1600 1400	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	13000 9500	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, I_F = 150\text{ A}$	V_F		1,20		V
Schleusenspannung Threshold voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_{TO}		0,83		V
Ersatzwiderstand Slope resistance	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	r_T		2,30		$\text{m}\Omega$
Sperrstrom Reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, V_R = 1600\text{ V}$	I_R		1,00		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode	R_{thJC}			0,35	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}		0,165		K/W

prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0

**Vorläufige Daten
Preliminary Data**

**Thyristor-Gleichrichter / Thyristor-rectifier
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip Maximum RMS forward current per chip	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	150	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom Maximum RMS current at rectifier output	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSmax}	180	A
Stoßstrom Grenzwert Surge forward current	$t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	1550 1300	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	I^2t	12000 8450	A^2s
kritische Stromsteilheit Critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 60 754-6 $f = 50\text{Hz}, i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$	100	$\text{A}/\mu\text{s}$
kritische Spannungssteilheit Critical rate of rise of on-state voltage	$T_{vj} = 130, v_D = 0,67 V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, I_F = 150\text{A}$	V_F		1,30		V
Schleusenspannung Threshold voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	$V_{(TO)}$	-	0,85		V
Ersatzwiderstand Slope resistance	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}$	r_T	-	3,20		$\text{m}\Omega$
Zündstrom Gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{V}$	I_{GT}			100	mA
Zündspannung Gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{V}$	V_{GT}			2,0	V
Nicht zündender Steuerstrom Gate non-trigger current	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{V}$ $T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	I_{GD}			6,0 3,0	mA
Nicht zündende Steuerspannung Gate non-trigger voltage	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, v_D = 0,5 V_{DRM}$	V_{GD}			0,3	V
Haltestrom Holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{V}, R_A = 5\Omega$	I_H			220	mA
Einraststrom Latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 6\text{V}, R_{GK} \geq 20\Omega$ $i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}, t_g = 10\mu\text{s}$	I_L			550	mA
Zündverzögerung Gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{GM} = 0,6\text{A}, di_G/dt = 0,6\text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}			1,2	μs
Freiwerdezeit Circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, i_{TM} = 50\text{A}$ $V_{RM} = 100\text{V}, V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$	t_q		150		μs
Sperrstrom Reverse current	$T_{vj} = 130^{\circ}\text{C}, V_R = 1600\text{V}$	I_R I_D	-	5,00		mA
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Thyristor / per Thyristor	R_{thJC}			0,30	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Thyristor / per Thyristor $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R_{thCH}			0,14	K/W

prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0



**Vorläufige Daten
Preliminary Data**

**IGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ I_C	100 140	A A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	200	A
Gesamt-Verlustleistung Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	515	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.		
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 100\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,75 2,05 2,10	2,20	V V V	
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 3,55\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		Q_G	0,80			μC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	7,5			Ω
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	6,30			nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,27			nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}			1,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}			100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,16 0,17 0,17			μs μs μs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,03 0,04 0,04			μs μs μs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,33 0,43 0,45			μs μs μs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,08 0,145 0,17			μs μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	5,50 8,50 9,50			mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L_S = 30\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	5,50 8,50 9,50			mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	360			A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}			0,29	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,135			K/W

prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0



**Vorläufige Daten
Preliminary Data**

**Diode, Brems-Chopper / Diode, Brake-Chopper
Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	50	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	100	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_P = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	510	A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ $I_F = 50 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F	1,70 1,65 1,65	2,15	V V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	$I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{RM}	54,0 60,0 63,0		A A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	$I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	Q_r	5,50 8,80 10,0		μC μC μC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	$I_F = 50 \text{ A}, -di_F/dt = 3000 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 600 \text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{rec}	1,70 3,00 3,70		mJ mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		R_{thJC}		0,81	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$		R_{thCH}	0,375		K/W

prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0



**Vorläufige Daten
Preliminary Data**

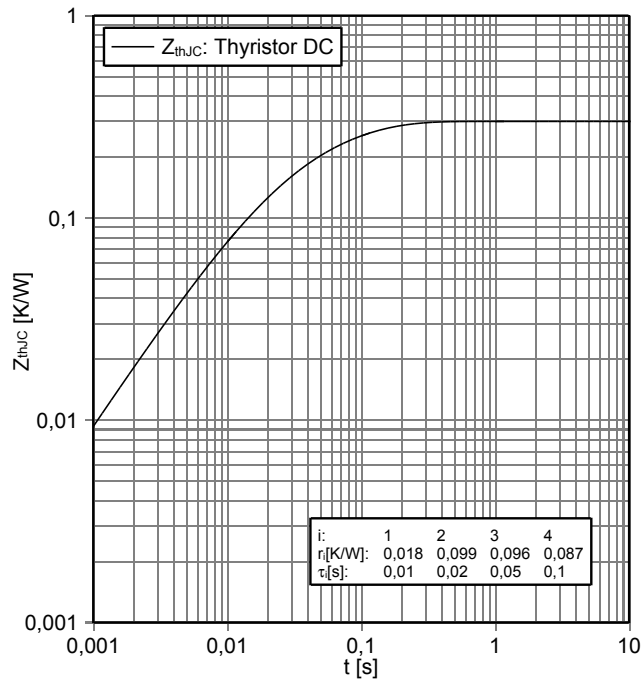
Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V _{ISOL}	2,5		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate			Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)		Al ₂ O ₃		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		7,5		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI	> 200		
min. typ. max.					
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)} / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	R _{thCH}	0,02		K/W
Modulstreuintuktivität Stray inductance module		L _{sCE}	50		nH
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur Maximum junction temperature	Wechselrichter, Brems-Chopper / inverter, brake-chopper Gleichrichter / rectifier	T _{vj max}		175 130	°C °C
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions	Wechselrichter, Brems-Chopper / inverter, brake-chopper Gleichrichter / rectifier	T _{vj op}	-40 -40	150 130	°C °C
Lagertemperatur Storage temperature		T _{stg}	-40	125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M5 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M5 - Mounting according to valid application note	M	3,00	-	6,00 Nm
Gewicht Weight		G	180		g

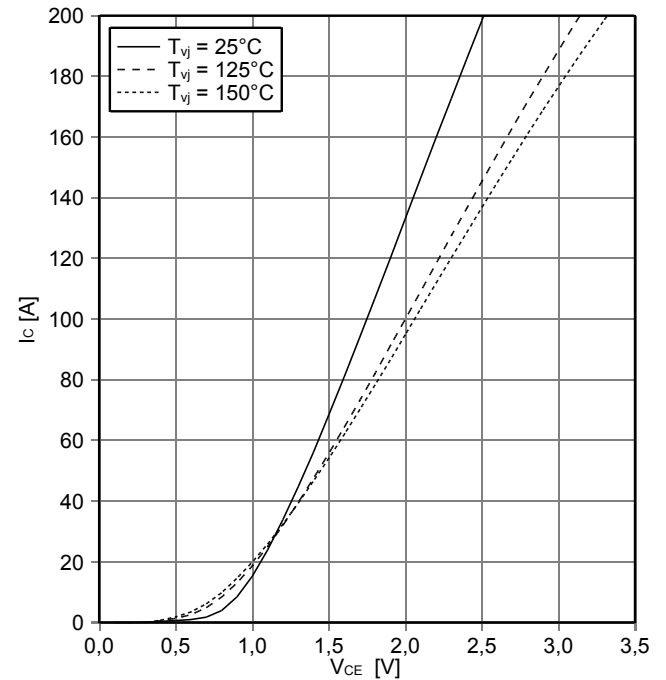
prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0

**Vorläufige Daten
Preliminary Data**

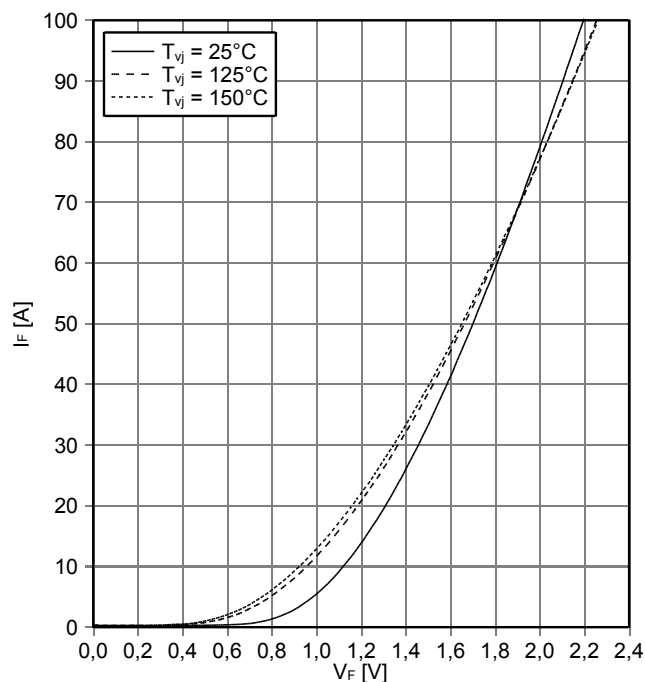
Transienter Wärmewiderstand Thyristor-Gleichrichter
transient thermal impedance Thyristor-rectifier
 $Z_{thJC} = f(t)$



Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



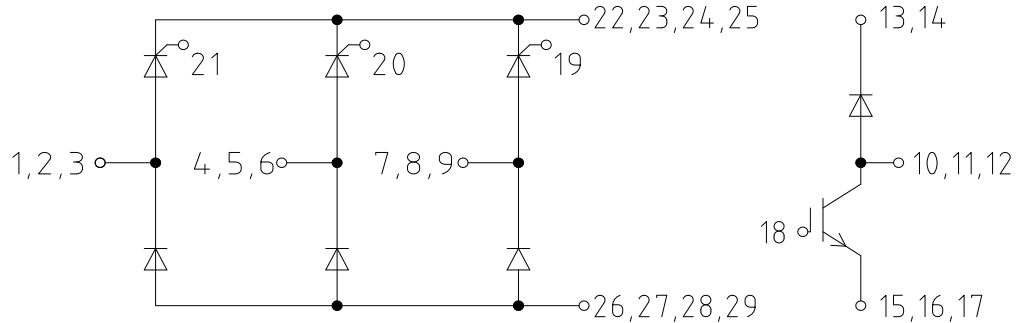
Durchlasskennlinie der Diode, Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)
 $I_F = f(V_F)$



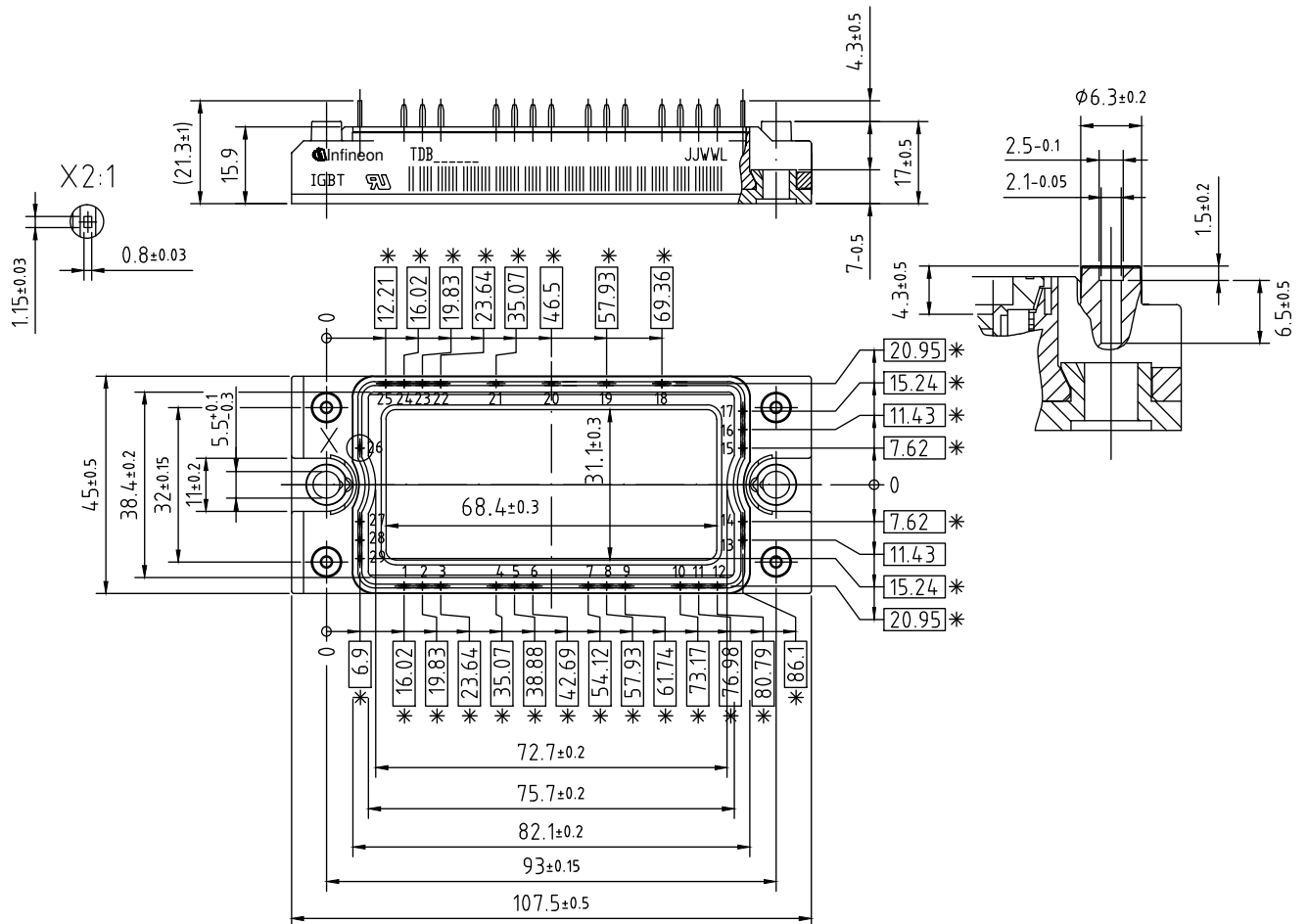
prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0

Vorläufige Daten
Preliminary Data

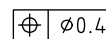
Schaltplan / circuit_diagram_headline



Gehäuseabmessungen / package outlines



* = alle Maße mit einer Toleranz von
* = all dimensions with tolerance of



prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0

Vorläufige Daten Preliminary Data

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: NK	date of publication: 2013-08-19
approved by: RS	revision: 2.0